

客户宝号: _____

规格书

品名规格: M11A-BCAN-12.00MHz

出 图			承 认 印
制 图	审 核	核 准	请于承认签章 谢谢!
日期: 2015年01月05日			

广东大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 13-16 栋

TEL: 0086-0769-88010888 FAX: 0086-0769-81800098



产品技术参数指标

型号: **M11A-BCAN-12.00MHz**

1. 输出

- | | |
|-----------------------|---|
| 1.1. 频率 | 12.00MHz |
| 1.2. 波形 | HCMOS |
| | $V_{oh} \geq 2.7V$, $V_{ol} \leq 0.4V$ |
| 1.3. 占空比 | 45%~55% @50% |
| 1.4. 上升/下降时间(10%~90%) | $\leq 5ns$ |

2. 频率稳定度

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| 2.1. 温度特性 | $\leq \pm 2.0 \times 10^{-7}$ | @-30°C ~ +70°C | @25 °C |
| 2.2. 电压特性 | $\leq \pm 5.0 \times 10^{-8}$ | @3.3VDC $\pm 5\%$ | |
| 2.3. 负载特性 | $\leq \pm 5.0 \times 10^{-8}$ | @Load $\pm 5\%$ | |
| 2.4. 老化率 | $\leq \pm 2.0 \times 10^{-8}/日$ | | |
| | $\leq \pm 1.0 \times 10^{-6}/第一年$ | | |

3. 电压

- | | |
|-----------|-------------------|
| 3.1. 工作电压 | +3.3VDC $\pm 5\%$ |
|-----------|-------------------|

4. 电流

- | | |
|-----------|----------------|
| 4.1. 工作电流 | 10mA (Typical) |
|-----------|----------------|

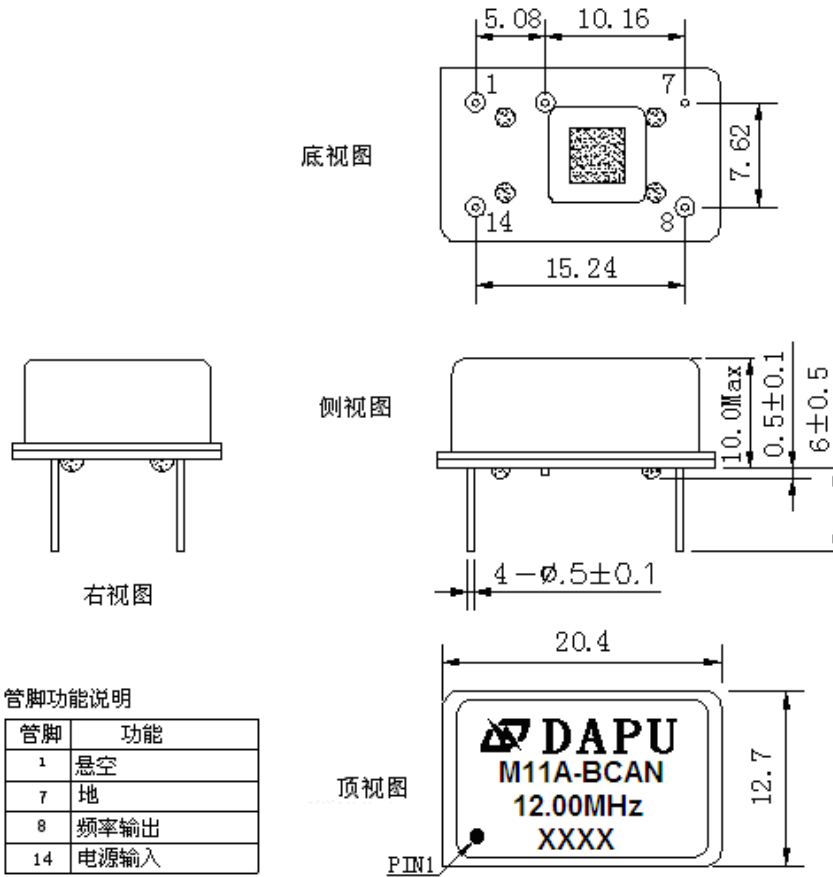
5. 环境特性

- | | |
|-----------|-----------------|
| 5.1. 工作温度 | -30°C To +70°C |
| 5.2. 存储温度 | -40 °C To +85°C |



6. 机械结构:

6.1. 外形尺寸及管脚定义



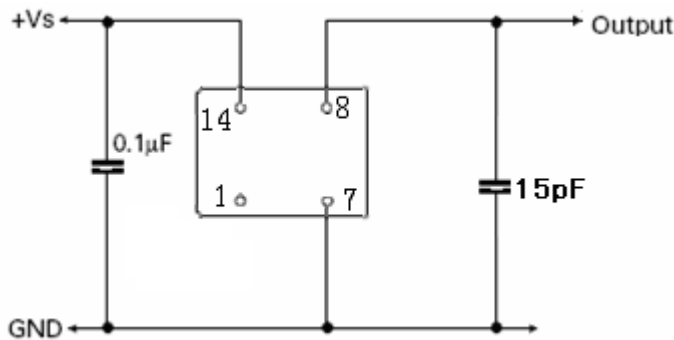
注 1: 底视图为针脚正对着观察者, 参考重量约为 4.2g

单位: mm

注 2: 未标注公差为 ±0.2mm

注 3: 1) 前两个 XX 代表: 周
2) 后两个 XX 代表: 年

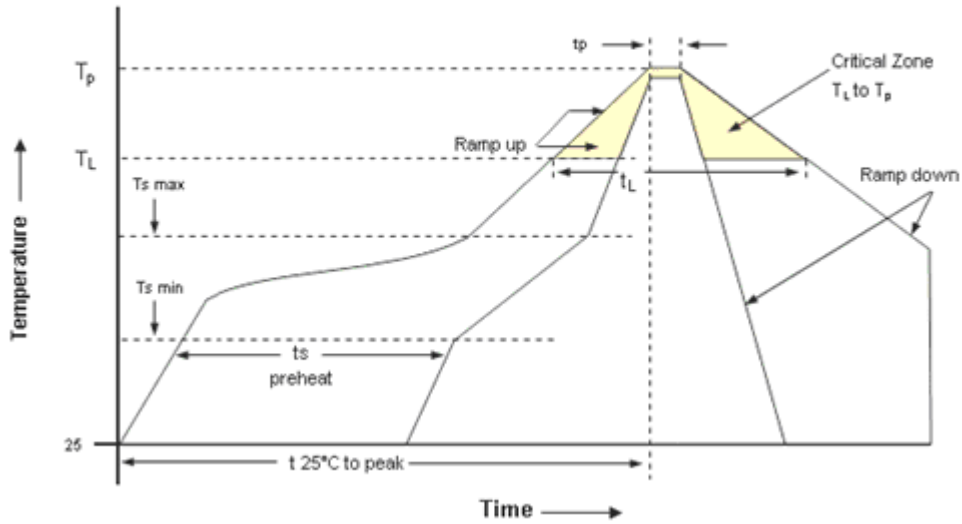
7. 电路图





8. 波峰焊曲线图

Solderprofile:



Profile Feature	Pb-Free Assembly	Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate (T_L to T_p)	3°C/second max.	Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.
Preheat - Temperature Min ($T_{s_{min}}$) - Temperature Min ($T_{s_{max}}$) - Time (min to max) (t_s)	150°C 200°C 60-180 seconds	Time maintained above - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
$T_{s_{max}}$ to T_L - Ramp-up Rate	3°C/second max.		
Time maintained above - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds	Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Peak Temperature (T_p)	max 260°C	Ramp-down Rate	6°C/second max.

Note: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.